



260°C 고온 특수 접착제 : 7050, S5H13, 4463

나일론 본딩, 고온 살균, 저팽창성



230°C - Bond-IT™ 7050

상온경화, 플라스틱 접착용 본드, 슈퍼 나일론 본드

거의 모든 플라스틱의 표면에 플라스틱 기질보다 더욱 강한 힘으로 접착합니다. 금속, 세라믹, 플라스틱, 유리, PVC, 나일론 고성능 복합소재 등 이종 재료의 조합을 접착하고 상온에서 경화합니다.

■ 사용자 보고서

- : 고성능 조명 기구에 결합 강도가 있는 알루미늄 하우징과 나일론을 접착 (나일론+알루미늄)
- : 사용하기 쉬운 디스펜서 키트로 포장되어 있어서, 실험실 또는 생산 시설에 이상적
- 사용법 : 레진 100g에 하드너 10g의 비율로 혼합하여 상온경화 또는, 120°C에서 1~2시간 열경화 합니다.



7050 - 석영램프를 플라스틱홀더에 접착



7050-1 (주사기 형태)



S5H13 - 양극 전기 소작기 밀봉



S5H13-1 (pint) 제품

260°C - Resbond™ S5H13

고온살균, 내부식/내화학적, 열충격 및 전기저항성

반복적인 살균, 멸균 처리가 가능하고 이종 물질을 접착하고 고온에서도 그 접착성을 유지합니다.

금속, 플라스틱, 고성능 복합 소재, 유리, 세라믹 등에 그냥 발라주면 강력한 접착력을 발휘합니다.

■ 사용자 보고서

- : 의료 기계/기구, 전자 및 항공/자동차 분야의 특별한 사양에 접착, 포팅, 밀봉 및 코팅 용도로 사용
- : 전기 소작기 및 전자 뚫기에 적용하고 190°C에서 수천번 멸균소독해도 그 성능이 유지
- 사용법 : 레진 100g에 하드너 13g의 비율로 혼합하여 상온경화 또는, 120°C에서 4시간 열경화 합니다.

260°C - Duralco™ 4463

저 팽창성 접착 및 포팅, 상온경화

대부분의 유리, 세라믹, 금속, 플라스틱 등에 접착하고 고성능 접합 및 캡슐화 응용 분야에 사용합니다.

저팽창은 많은 전자, 광학 및 광섬유 응용 분야에서 필수 요소이며, 강도, 고온 안정성, 열충격 저항, 내화학적 및 낮은 수축률을 제공합니다.

- 사용법 : 레진 100g에 하드너 6g의 비율로 혼합하여 상온경화 또는, 120°C에서 1~2시간 열경화 합니다.

■ 접착물질

카본	알루미늄	스테인레스	금속	세라믹	유리	플라스틱	복합소재
	○	○	○	○	○	○	○

구분	7050	S5H13	4463
최대온도(°C) - Max. Use Temperature	230	260	260
혼합밀도(gms/cc) - Mixed Density	1.3	1.9	1.5
혼합점도(cps) - Mixed Viscosity	5,000	12,000	176,000
경도(Shore D) - Hardness	70	85	75
인장강도(psi) - Tensile Strength	5,000	10,000	7,000
열전도(BTU-in/Hr. Ft²F) - Thermal Conductivity	4.5	13	3.54
열팽창(10⁻⁵/°C) - Thermal Expansion	4.8	3.3	2.0
유전력(volts/mil.) - Dielectric Strength	400	500	600
저항률(ohm-cm) - Volume Resistivity	10¹⁴	10¹⁵	10¹⁴
열변형(°C) - Heat Distortion	75	210	210
연신율(%) - Elongation	3	2	2
열안정성(%1000hr@200°C) - Thermal Stability	0.5	0.5	0.5
수축률(%max) - Shrinkage	0.8	0.2	0.5
수분흡수율(%30days) - Moisture Absorption	0.2	0.2	0.3
혼합비율 - Mixed Ratio	100:10	100:13	100:6
경화(hrs@R/T)	4~16	16~24	4~16
(hrs@120°C)	10min	1~2	1~2

■ 판매단위

- 7050 : Dispenser kit / Pint kit
- S5H13 : Pint / Gallon
- 4463 : ½ pint / Pint